

Szablony wycinane laserowo do nakładania pasty i kleju SMT
Szablony na ramach Al oraz ramach typu Vector Guard
Szablony stopniowane (step up – step down)
Mikroszablony do reballingu BGA

Szablony wycinane są za pomocą obrabiarek laserowych, urządzeń najnowszej generacji produkcji firmy LPKF Laser & Electronics AG.

SL G 6080 – z głowicą laserową wyposażoną w kontrolę on-line wycinanych apertur

SL G 6060 – (po upgrade)

W urządzeniach tych głowica światłowodowego lasera impulsowego YAG jest ruchoma a nie, jak w przypadku urządzeń starszej generacji LPKF, zamocowana na stałe. Droga prowadzenia promienia laserowego gwarantuje wierne odtworzenie kształtu wycinanych apertur i zapobiega charakterystycznym zniekształceniom apertur, typowym dla urządzeń poprzedniej generacji.

Dzięki zastosowaniu precyzyjnych układów napędowych X-Y, urządzenie to charakteryzuje się dużą precyzją ($\pm 2\mu$) i powtarzalnością ($\pm 2\mu$) cięcia.

Materiał

1. folia stalowa hartowana SS304
 - grubości (standardowe): 80, 100, 120, 130, 150, 180, 200 μ m
 - grubości: 250, 300, 350, 400, 500, 600 μ m – proszę sprawdzić aktualną dostępnośćSzerokość folii: max 650mm
2. folia niklowa
 - grubości 100, 120, 150 μ m - inne grubości na zamówienie

Wymiary szablonu

- max pole cięcia 600 x 800mm
- max wymiary folii – 650 x 850mm
- grubość folii stalowej - 20 μ - 1000 μ

Szablony na ramach aluminiowych

Oferujemy szablony na ramach aluminiowych z naciągami siatkowym:

- 23" x 23" – 584 x 584mm, profil 30 x 38mm – folia stalowa 120, 130, 150 μ m
 - 550 x 650mm, profil 30 x 38mm – folia stalowa 120, 130, 150 μ m
- 29" x 29" – 737 x 737mm, profil 38 x 38mm – folia stalowa 80, 100, 120, 130, 150, 180, 200, 250, 300 μ m
 - folia niklowa 100, 120, 150 μ m
- inne wymiary na zamówienie

Uwaga!

Dostępne są szablony do wyrobów LED na ramach Al o długości ponad 1000mm

Szablony na ramach typu Vector Guard

- wymiary 23" x 23"
23" x 29"

Szablony o stopniowanej grubości

wymiary szablonu: max 600 x 800 mm

- step up – do 100 μ m
- step down – do 30-50 μ m (zależnie od grubości folii)
- różne technologie wykonania stopni

- mikrospawanie laserowe

Szablony dostępne również na ramach aluminiowych z naciąganiem siatkowym.

Mikroszablony

- do napraw układów BGA, QFN...
- grubość do 500μ
- tworzenie dokumentacji CAD układu na podstawie schematu topologii połączeń lub wzoru układu

Gwarancja jakości

- Najwyższe modele urządzeń LPKF o najlepszych parametrach technicznych
- Regularne przeglądy konserwacyjne przez Serwis LPKF
- Coroczne kalibracja urządzenia przez Serwis LPKF
- Urządzenie monitorowane przez producenta LPKF, poprzez zdalne łącze serwisowe
- Światowej renomy dostawca folii stalowych oraz folii niklowych
- Kontrola grubości wycinanej folii, kontrola siły naciągu szablonu na ramie
- Kontrola apertur przy użyciu skanera A3 o dużej rozdzielczości i wykorzystaniu specjalistycznego oprogramowania LPKF, na zgodność plików Gerber z wyciętym szablonem
- na życzenie raport jakościowy
- Wycięte apertury badane są wrywkowo przy pomocy mikroskopu w celu kontroli poprawności procesu cięcia laserowego
- Proces wycinania laserowego szablonów SMT objęty jest certyfikatami:
ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 oraz AQAP 2110:2009

Format plików:

- Gerber RS274 x 2.4
- pliki z rozszerzeniem dxf
- PCB formatki – Protel, Orcad, Eagle – dodatkowa opłata za generowanie zbiorów
- inne formaty do uzgodnienia

Kontakt: ul. Ezopa 71a, 04-805 Warszawa

tel. (22) 615 27 05

(22) 615 83 47

szablony@semicon.com.pl